



kingston.com/epop

ePoP

ePoP - memoria integrada Package-on-Package para dispositivos portátiles

ePoP de Kingston proporciona un componente estándar JEDEC altamente integrado que combina almacenamiento de MultiMediaCard integrada (eMMC) y DRAM de doble velocidad de datos de bajo consumo (LPDDR) en una solución Package-on-Package (PoP). ePoP se monta directamente encima de un System-on-a-Chip (SoC) huésped compatible, lo que reduce el espacio de la Placa de circuito impreso "Printed Circuit Board" (PCB) y garantiza un rendimiento óptimo. ePoP es una solución ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles.

BENEFICIOS FUNDAMENTALES

- Al montarse directamente sobre un SoC host, la ePoP proporciona una solución ideal para aplicaciones de factor de forma pequeño, como dispositivos portátiles.
- La DRAM de bajo consumo y el firmware de almacenamiento optimizado reducen el consumo de energía y ofreciendo el rendimiento necesario para las aplicaciones portátiles alimentadas por batería.
- Simplifica el diseño del sistema, reduce el tiempo de comercialización y acorta el ciclo de calificación.
- Múltiples configuraciones de firmware disponibles para adaptarse mejor a los requisitos de su aplicación en cuanto a rendimiento, potencia y vida útil.

SEGMENTOS DE MERCADO



IoT



Dispositivos portátiles

Dispositivos de Realidad Aumentada (AR)/
Realidad Virtual (VR)

EPOP CÓDIGOS DE ARTÍCULO Y ESPECIFICACIONES

ePoP basado en LPDDR3

Código de artículo	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperaturas de operación
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10x10x0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP basado en LPDDR4x

Código de artículo	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperaturas de operación
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C

*Modo pSLC para mayor resistencia

